# Strength Evaluation of Aluminium Cast Alloy Locally Reinforced by SiC Particles and Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Whiskers and Its Fractography

荒居 善雄1\*

Yoshio ARAI<sup>1</sup>

1 埼玉大学大学院理工学研究科
1 School of Science and Engineering, Saitama University

## Abstract

In this paper, fracture mechanisms under monotonic and cyclic load and its stress distribution of an aluminumcast alloy locally reinforced by SiC particles and  $Al_2O_3$  whiskers are investigated experimentally and numerically. The material is monotonically and cyclically deformed to failure at room temperature. The fracture origin and the fracture path are investigated on the fracture surfaces. The fracture occurs in the reinforced part under both monotonic and cyclic loads. SEM analysis of the fracture surface shows that the fatigue fracture is controlled by the fracture of coarse  $Al_2O_3$  whiskers. On the other hand the static fracture (monotonic loading) shows that the fracture mechanism is the combination of reinforcing particle fracture and interfacial debonding between reinforcing ceramics and matrix metal. The stress distributions around the boundary between the reinforced part and unreinforced part are calculated based on an inclusion array model considering the microscopic inhomogeneous effects. Both the experimental results and the finite element simulation results show that the critical location for fracture is changed by the external stress level which controls the local stress distribution through plastic constraint between reinforcing particle and matrix alloy.

### Keywords: Metal Matrix Composites (MMCs), Fracture, Fatigue, Fractography, Locally Reinforced Material

### 1. 緒 言

低密度の金属をマトリックスに用いセラミ ックスの繊維, ウィスカあるいは粒子を強化 材とした金属基複合材料(MMC)は比剛性,比 強度が高く,耐磨耗性に加えて耐熱性も優れて いる1).本研究では,MMC(SiC 粒子とAl<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ウ ィスカ強化)/Al(アルミニウム鋳造合金) 接合材 の静的破壊試験および疲労試験を行うととも に,破断面の解析と成分分析を行い,その破壊 機構を明らかにした.さらに,MMC 部とアル ミ合金部の境界部近傍の破壊挙動を解明する 目的で,強化材の存在を考慮した介在物配列モ デルについて弾塑性応力解析を行い,その最大 応力発生位置および歪振幅を検討した.

### 2. 実験方法

SiC/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> プリフォームを部分的に配置した 高圧金型鋳造(圧力100MPa) で円板を製造した 後,熱処理としてT7 処理を行った.円板より短 冊形状の試験片を切り出した. セラミックに よる強化層(MMC 部)厚さは約7mmであり, MMC 部とアルミ合金部の巨視的境界は四点曲げ(内ス パン10mm, 外スパン20mm, 対称荷重) 内スパン 内に位置するが、その中央から3mm 程ずれてい る. 界面部の光学顕微鏡写真を図1に示す. MMC 部の母材はアルミ合金部の材料そのものであり, 微視的にはMMC 部とアルミ合金部の境界面は 存在しない. SiC 粒子の平均粒径は約23 μm, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ウィスカの平均長さは約33 µm, 平均直径 は約2 µm, Al 合金の平均粒径は約48 µmであ った. 図1(b) に一例を破線で示すように、SiC 粒 子とAl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>ウィスカはクラスターを形成しており, その平均直径は約90 µm であった.

<sup>(\* 〒338-8570</sup> 埼玉県さいたま市桜区下大久保255) 電話:048-858-3438 FAX:048-856-2577 E-mail:yarai@mech.saitama-u.ac.jp)

単調曲げ試験は四点曲げで,荷重点の変位速度 0.0025 mm/s 一定で破断まで負荷した.最大荷重 から公称曲げ応力を算出し,曲げ強度とした.疲 労試験は荷重制御で行い,応力比は0.1,周波数は 1 および10Hz である.試験片表面を光学顕微鏡 で,破面を走査型電子顕微鏡で観察するとともに, X 線による成分分析(EDX)を行った.特に,マッ チング破面の様相と成分を調べ,破壊機構を考察 した.破面を構成するアルミ合金のディンプル, SiC 粒子割れ,SiC 粒子/母材界面はく離,Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ウィスカ割れ,Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ウィスカ/母材界面はく離の 破面率を,引張側表面から深さ50µm の範囲を 試験片全幅に渡って調べ,その平均値を算出した.



実験結果および考察

(b) Low magnification.

Fig. 1 Optical microscope photograph of the specimen around the boundary betwee reinforced part and unreinforced part.



Fig. 2 Nominal bending stress versus deflection curves under monotonic loading.

単調曲げ試験における公称応力-荷重点変位 曲線を図2に示す.応力が200MPa以上において 公称応力-荷重点変位曲線に非線形性が顕著に 現れている.平均曲げ強度は298MPaであっ た.MMC/Al接合材の単調曲げ試験による破壊 後の引張応力側表面の巨視的様相を図3に,破 壊起点MMC/Al境界の距離を表3に示す.破壊起 点はAIとMMCの境界部の一つないし二つ目の SiC 粒子割れ、またはSiC粒子/母材界面であっ た.図4に単調曲げ試験の破面(図3の表面写真に 対応した位置)のマッチング写真を示す.破面上 には、アルミ合金のディンプル破面に加えて、 SiC粒子割れ, SiC粒子/母材界面はく離, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ウィスカ/母材界面はく離破面が観察された.破 面のEDX分析において、図4のPの矢印ではSiと 少量のAlが検出され、SiC粒子、Mの矢印では Alと少量のSiが検出され、Al母材、Wの矢印で はAlが検出され, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>ウィスカと, それぞれ考 えられる.そこで, 破面のマッチング写真上でP とPのペアはSiC粒子割れ、PとMのペアはSiC粒 子/母材界面はく離、WとMのペアはAl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>ウィ スカ/母材界面はく離と、それぞれ判断される. 破面率を表4に示す.Monotonic はTP1, 2, 3の結 果の平均値, Cvclic は後述する疲労試験の CTP4とCTP5の平均値である. 単調曲げ試験の 破面では、SiC粒子割れ、SiC 粒子/母材界面は く離、Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>ウィスカ/母材界面はく離の破面率 がほぼ同率であった.すなわち,強化粒子と母材 の界面はく離のみならず、SiC粒子割れも生じ ており, 強化粒子内に高い応力が発生している ことが考えられる.単調曲げ負荷時に,強化粒子 は弾性変形し,母材は弾塑性変形する.強化粒子 と母材の間の塑性拘束が強化粒子内に高い応 力を生じさせていると考えられる.

疲労試験におけるS-N線図を図5に示す.水平の 矢印は10<sup>-</sup>回で打ち切った試験結果を示す.疲労破 壊は単調曲げ強度の約1/2の繰返し応力における 公称応力の最大値(以下σmaxと略す)まで生じてい る.表5に示すように,σmaxが低く,母材が弾性変 形する状態においては(表5のCTP4,5,6,7)破壊 起点はMMCとAlの境界部からはるか遠いMMC内 (0.28mm)であった.単調曲げ試験においては, MMCとAlの境界部の一つないし二つ目のSiC 粒 子で破壊した.



Fig. 3 Matching surface view of fractured specimen (under monotonic loading,  $\sigma f = 272$  MPa).



Fig. 4 Matching fracture surface of locally reinforced material under monotonic loading,  $\sigma f = 272$  MPa.



Fig. 5 Stress versus fatigue life behavior (stress ratio, R=0.1).



Fig. 6 Matching surface view of fatigue fractured specimen under cyclic loading, maximum stress  $\sigma_{max}$ =156 MPa, Nf= 5.73 × 10<sup>5</sup>.



Fig. 7 Matching fracture surface after fatigue fracture,  $\sigma_{max}$ =156 MPa, Nf= 5.73 × 10<sup>5</sup>.

疲労試験においても、その $\sigma_{max}$ が高くMMC 内の母材の塑性歪が大きい場合,破壊起点は MMC とAl の境界部に極めて近い(表5 のCTP1 参照). 単調試験と疲労試験の破壊起点の相違は, 異なる変形様式(塑性変形/弾性変形) が原因と考 えられる. MMC/Al 接合材の疲労試験による破壊 後の引張応力側表面の巨視的様相を図6 に, 疲労 試験の破面のマッチング写真を図7 に示す. 図6 と図7 は対応した表面と破面である.図6 と図7 において, 破面のEDX 分析結果を示すWとM の 矢印の意味は単調曲げ試験の場合と同様である. WとWのペアはAl<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ウィスカの割れ, MとMの ペアはAlの疲労破面と判断される. すなわち,疲 労き裂は粗大Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ウィスカの割れから発生し, 母材中を進展したと考えられる. 疲労破壊の破面 率を表4 のCyclic の行に示す. 疲労破壊におい ては, SiC 粒子/母材界面はく離, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ウィスカ /母材界面はく離の破面が支配的であった. 単調 曲げ試験と疲労試験では破面率に明確な差が現 れた. 単調曲げ試験では強化粒子と母材の界面は く離のみならず、SiC 粒子割れも生じたが、疲労 試験ではSiC 粒子割れは極めてまれであった.

MMC/Al 接合材の破壊挙動を考察する目的で, 2 次元弾塑性有限要素解析を行った. 解析は平面 歪状態を仮定した.介在物配列モデルにおける MMC 部は、円形介在物を含む単位セルを格子上 に配列したものとなっている.x=0,以外の三つの 境界( $y = \pm L/2, x = h$ ) に, 均質材同志の接合材モ デの計算結果の対応する位置における変位を与え た. アルミ合金およびMMC の流動応力と塑性歪 の関係を表6 に示す.介在物配列モデルは強化粒 子の存在を円形介在物でモデル化したものであり、 供試材はSiC 粒子とAl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>の二種類の強化粒子を 含む.しかし、本研究では試みの第一歩として、一 種類の弾性係数を有する介在物を想定し、その円 形介在物の弾性係数には、SiC の弾性係数を用い た. 均質材同志の接合材モデルのMMC 部の弾性 係数は、同様の円形介在物を含む単位セルが二次 元的に無限に配列するモデルの一軸引張りの解析 結果から計算した. セラミック粒子は弾性体と仮 定し,粒子と母材界面は完全接着とした.数値計算 に用いた寸法を表7 に示す.8節点アイソパラメト リック要素と3節点定歪要素を用いた.要素寸法 を変え,計算結果の収束を確認した.最小要素寸法 は、均質材同志の接合材モデルの場合25 µm×11 μm, 介在物配列モデルの場合2.3μm×4.6μm で あった.考察の対象とする力学因子として,相当応 力や主応力も考えられるが、応力成分の内、最も

支配的なy方向垂直応力を選んだ.疲労試験結果の 考察の為に,引張側表面近傍の母材の全歪変化に 着目し,負荷に引き続く除荷過程の解析を行った.

単調曲げ試験において試験片が破断した,公称曲 げ応力300MPa 下の介在物配列モデルにおける引 張側表面に隣接した介在物列近傍のσ、の分布を 図8 に示す.また、疲労試験における最も低いσ<sub>max</sub> である公称曲げ応力156MPa 下の同様の分布を図9 に示す. 図8 および図9 は,介在物内の最大応力(四 角印) と介在物/母材界面の最大応力(丸印) の,介在 物ごとのy 方向分布を示す. 図8 より公称曲げ応力 が300MPa の場合には、最大応力(図9 の345MPa) はMMC 部とアルミ合金部の境界の一つ目の介在 物内に発生することがわかる. この最大応力は介在 物と母材の塑性拘束によって生じ, 粒子割れの原因 となると考えられる.この計算結果は、単調曲げ試 験においてMMC とAI の境界部の一つないし二つ 目のSiC 粒子で破壊が発生すること、および強化粒 子と母材の界面はく離のみならず, SiC 粒子割れが 生じることと対応している.一方,図9に示すとお り、公称曲げ応力が156MPa の場合には、最大応力 (図9 の197MPa) は介在物と母材の界面に生じ, 疲 労試験の破面において強化粒子と母材の界面はく 離が支配的であることと対応している.

疲労試験における最も低いσ<sub>max</sub> である公称曲 げ応力156MPa における最大応力時と完全除荷 時の全歪のy 方向分布を図10 に示す.公称曲げ 応力が156MPaと低く,介在物の強化作用により 母材の大部分が弾性変形する状態において,介在 物配列モデルは,MMC部の歪振幅の方がアルミ 合金部のそれよりも大きいことを予測できる.

### 4. 結 言

本研究では、部分的にSiC 粒子とAl<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ウィス カで強化されたアルミニウム鋳造合金の静的破壊 試験および疲労試験を行うとともに、破断面の解 析と成分分析を行い、その破壊機構を明らかにし た. MMC部とアルミ合金部の境界部近傍の破壊挙 動を解明する目的で、強化材の存在を考慮した介 在物配列モデルについて弾塑性応力解析を行い、 その最大応力発生位置および歪振幅を検討した. 得られた結果を要約すれば、以下のとおりである. (1) 単調曲げ荷重下および繰返し曲げ荷重下の 両方において、破壊はMMC 内で生じる. (2) 疲労試験の破面においては、強化粒子と母材の界 面はく離が支配的であり、単調曲げ試験では、強化粒 子と母材の界面はく離のみならず、SiC 粒子割れも生 じる. 強化材の存在を考慮した介在物配列モデルは、 最大応力の発生位置として、公称曲げ応力が低い場合 には介在物と母材の界面、公称曲げ応力が高い場合に は介在物内に発生することを予測できる。 (3)疲労破壊は、最大の公称曲げ応力が低く、 母材が弾性変形する状態においては、MMC と Al の境界部からはるか遠いMMC 内で生じ、 単調曲げ破壊は、MMC とAl の境界部の一番 目又は二番目のSiC 粒子の位置で生じる.単調 負荷における公称曲げ応力が高い場合には、最 大応力はMMC 部とアルミ合金部の境界の一 つ目の介在物内に発生し、繰返し負荷における 歪振幅は、MMC 部の方がアルミ合金部よりも 大きいことを、介在物配列モデルは予測できる.



Fig. 8 Stress distribution along *y* direction of inclusion array model under nominal bending stress 300 MPa.



Fig. 9 Stress distribution along *y* direction of inclusion array model under nominal bending stress 156 MPa.



Fig. 10 Distribution of total strain in matrix along normal to the boundary of inclusion array model under cyclic loading at maximum stress 156 MPa.